

# 平成21年3月期(第7期) 決算説明会

平成21年5月20日  
株式会社ジーダット



**上期は当初計画通りの売上・利益**

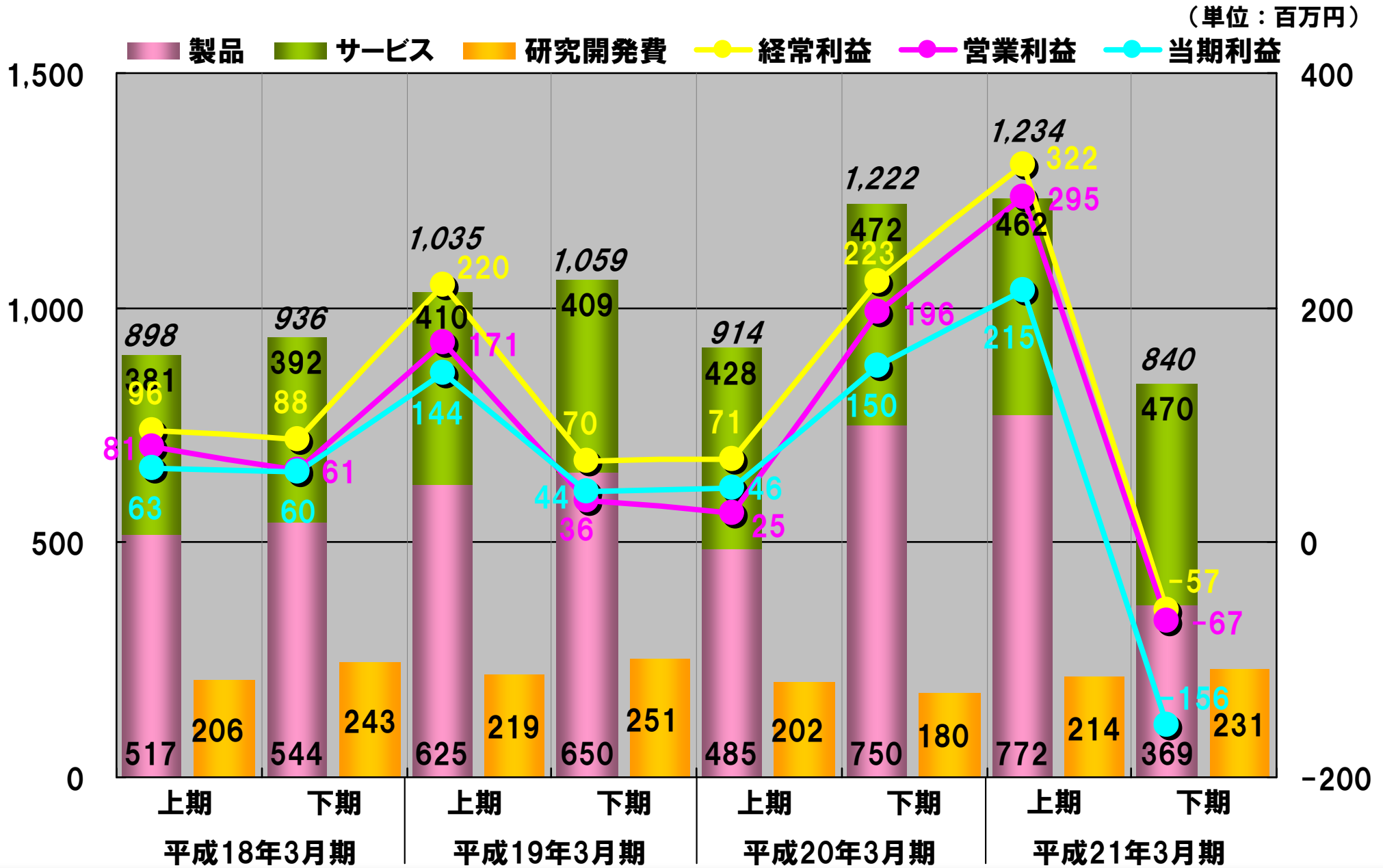
**下期は顧客投資凍結のため大幅下落**

**通期営業利益は前期比2.5%UP**

**当期利益は有価証券減損のため大幅下落**

**研究開発投資は計画通り 継続**

# 半期毎売上高・利益の推移



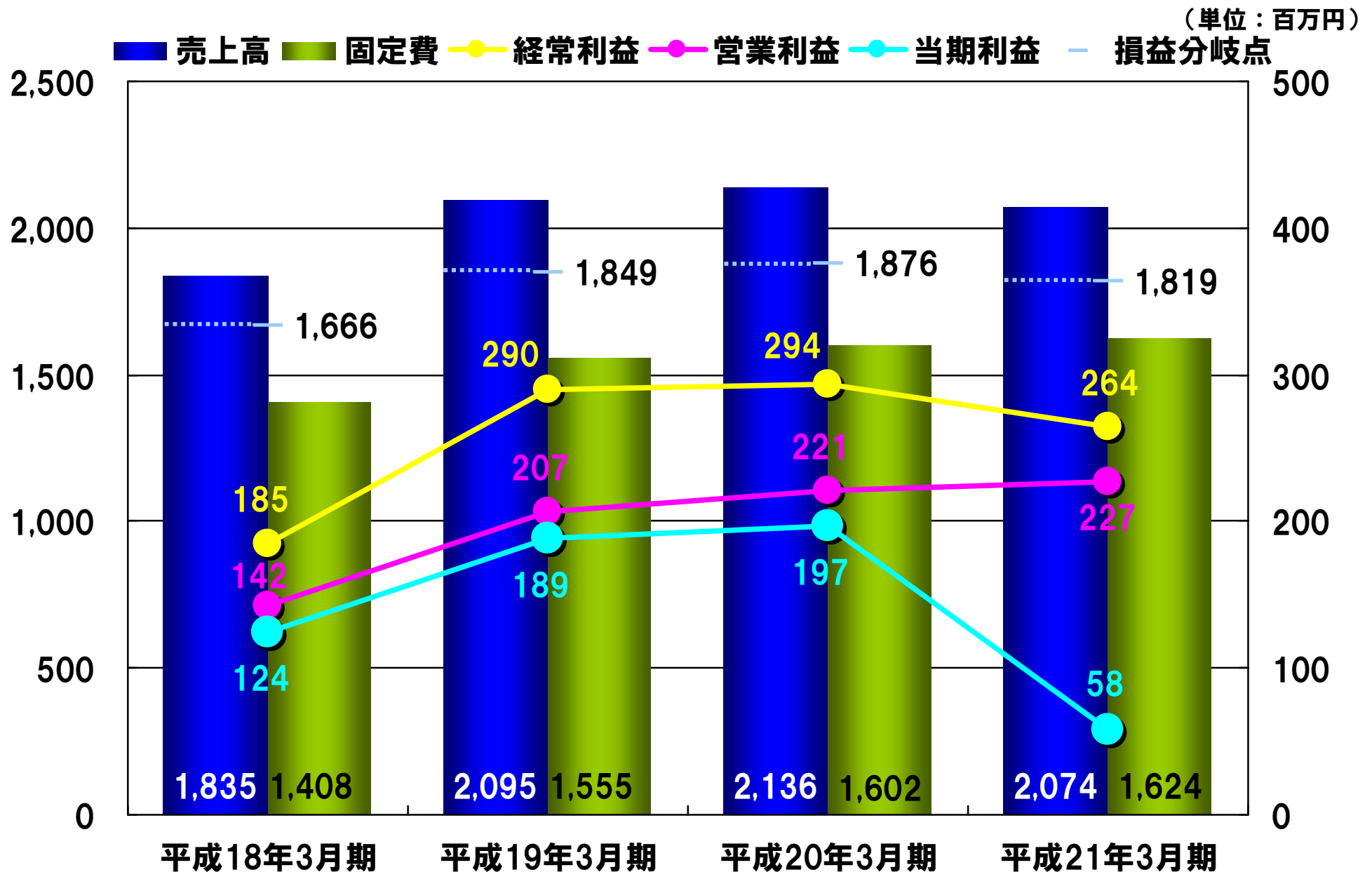


# 平成21年3月期業績概要(連結)

(単位：百万円)

	平成18年3月期 業績		平成19年3月期 業績		平成20年3月期 業績		平成21年3月期業績		
	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	対前年 同期比
売上高	1,835	100.0%	2,095	100.0%	2,136	100.0%	2,074	100.0%	-2.9%
売上総利益	1,284	70.0%	1,473	70.3%	1,478	69.2%	1,474	71.1%	-0.2%
販売費及び 一般管理費	1,141	62.2%	1,266	60.4%	1,256	58.8%	1,247	60.1%	-0.7%
営業利益	142	7.8%	207	9.9%	221	10.4%	227	11.0%	+2.5%
経常利益	185	10.1%	290	13.9%	294	13.8%	264	12.8%	-10.2%
当期純利益	124	6.8%	189	9.0%	197	9.2%	58	2.8%	-70.1%

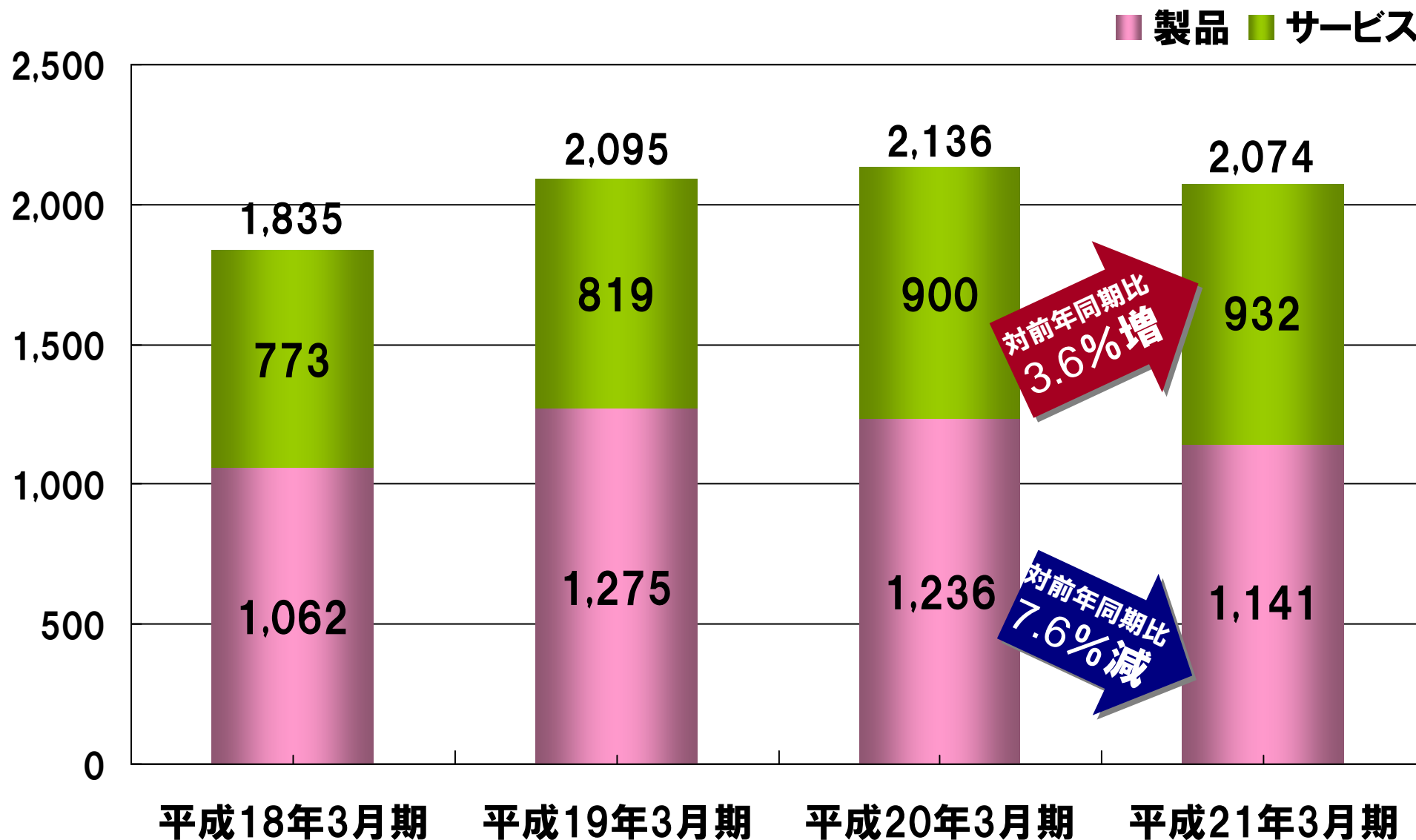
# 売上・利益の推移



# 事業別売上高の推移

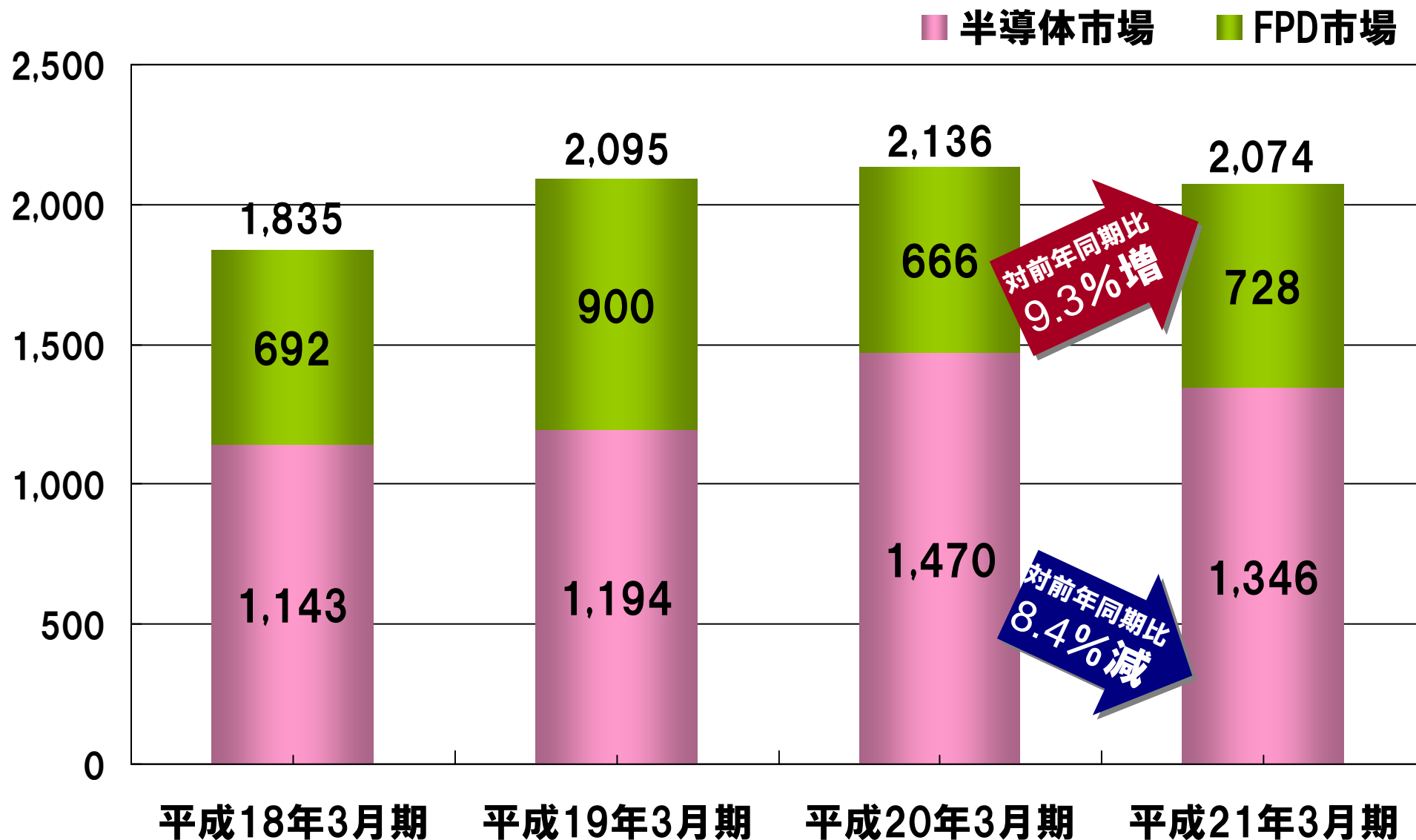
【製品／サービス】

(単位：百万円)



## 【半導体市場／FPD市場】

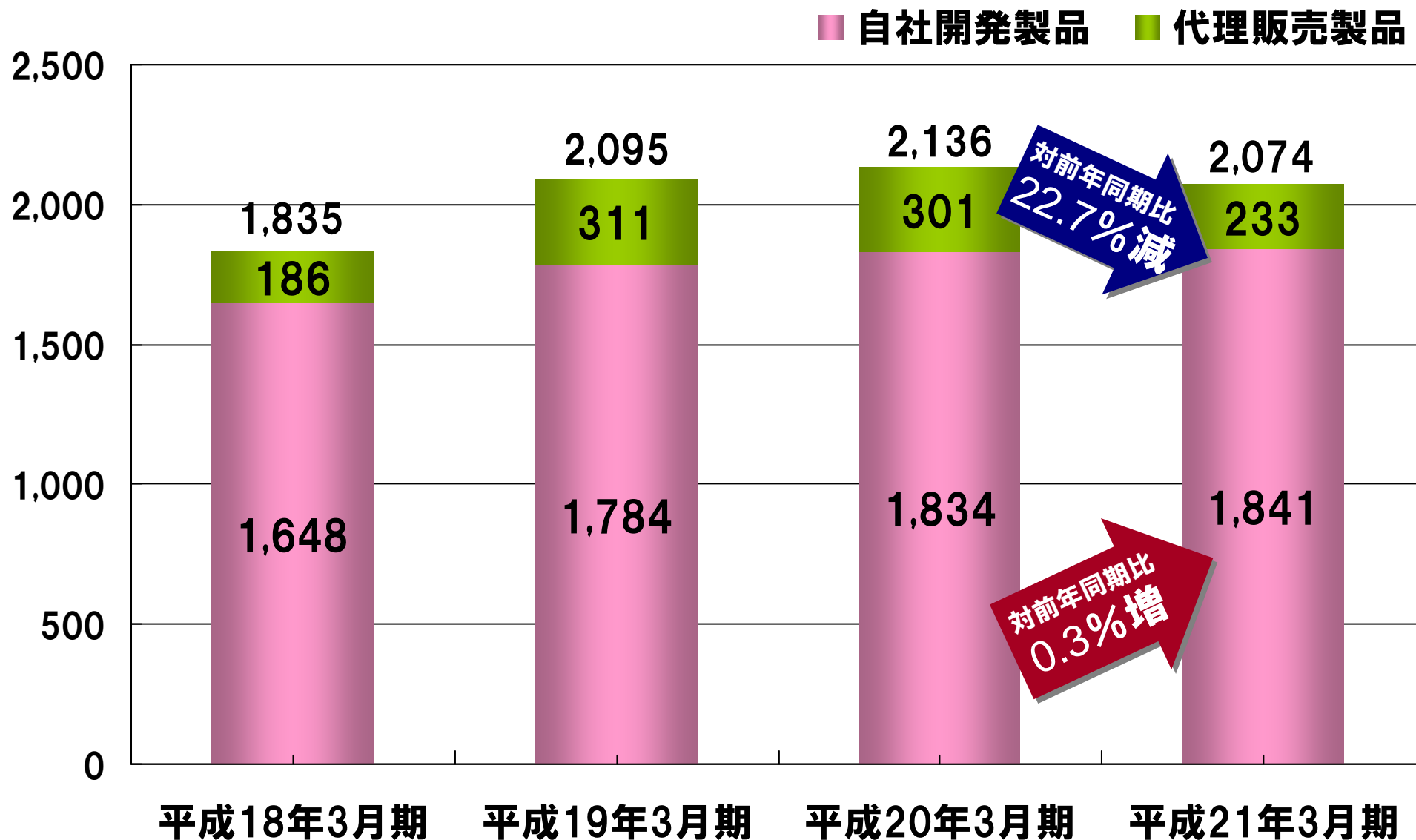
(単位：百万円)



# 製品区分別売上高の推移

## 【自社開発製品／代理販売製品】

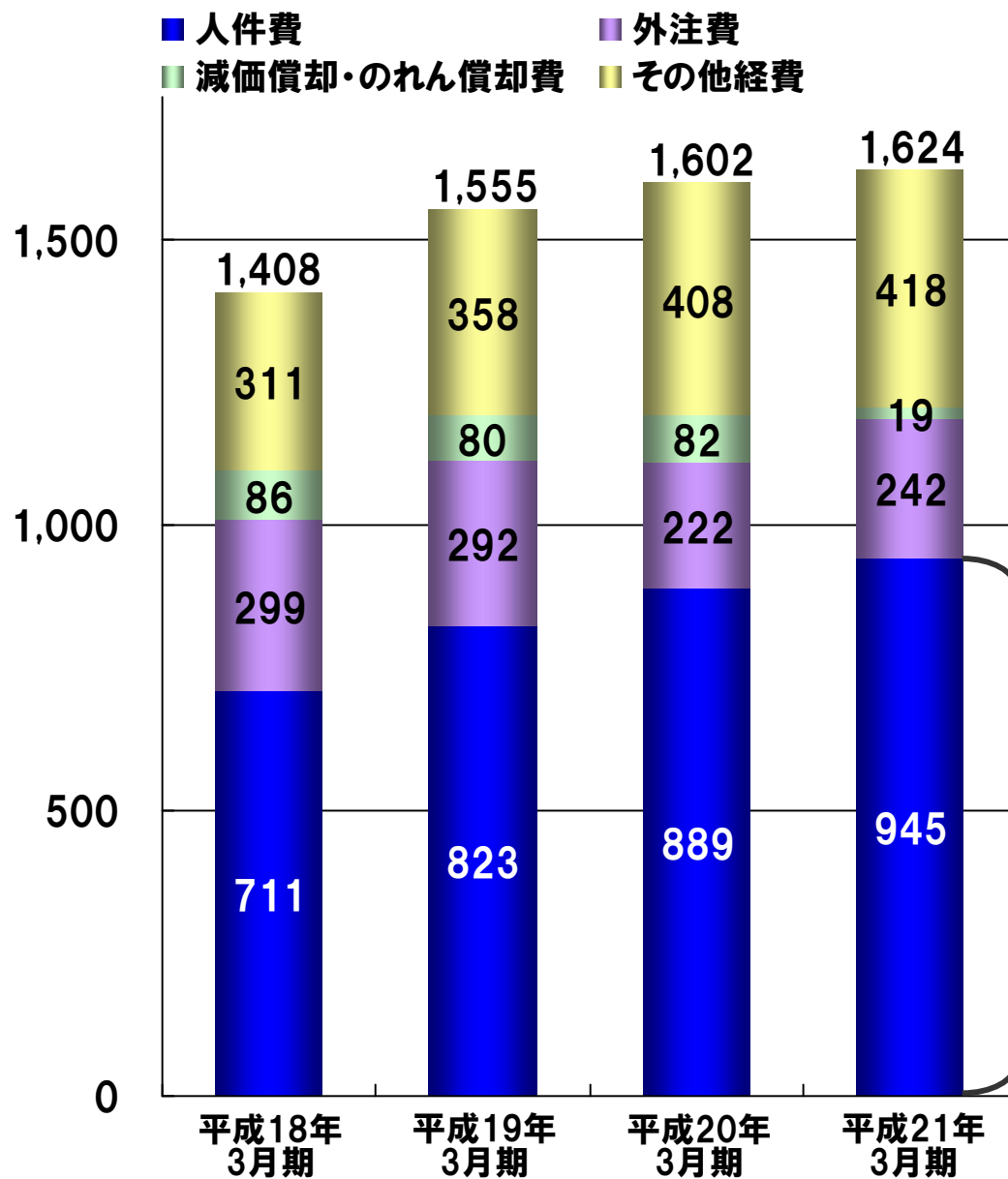
(単位：百万円)





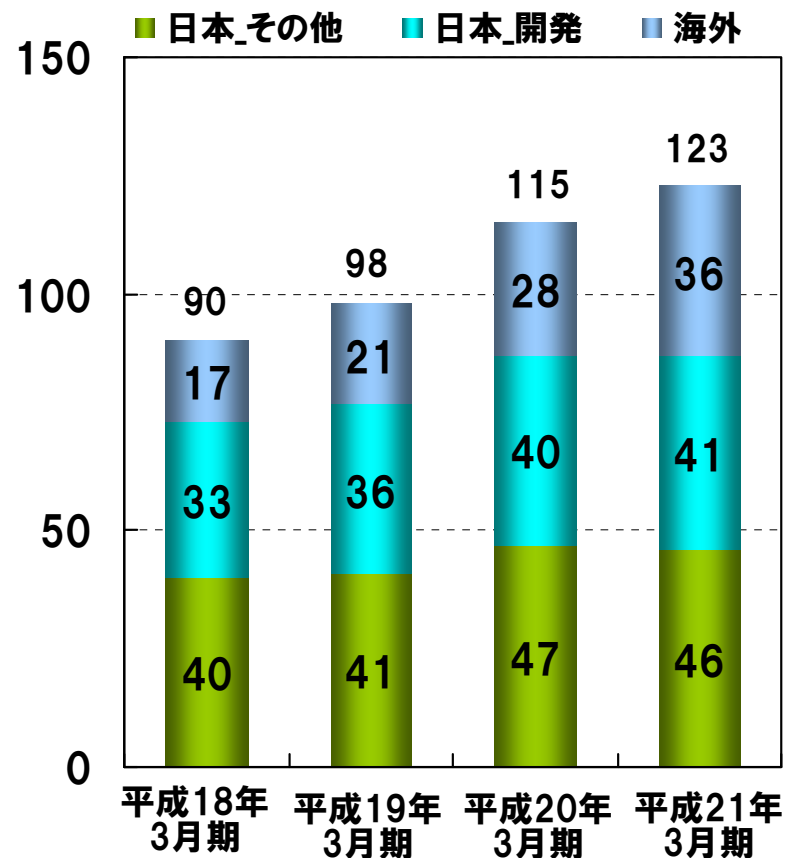
# 固定費内訳

(単位:百万円)

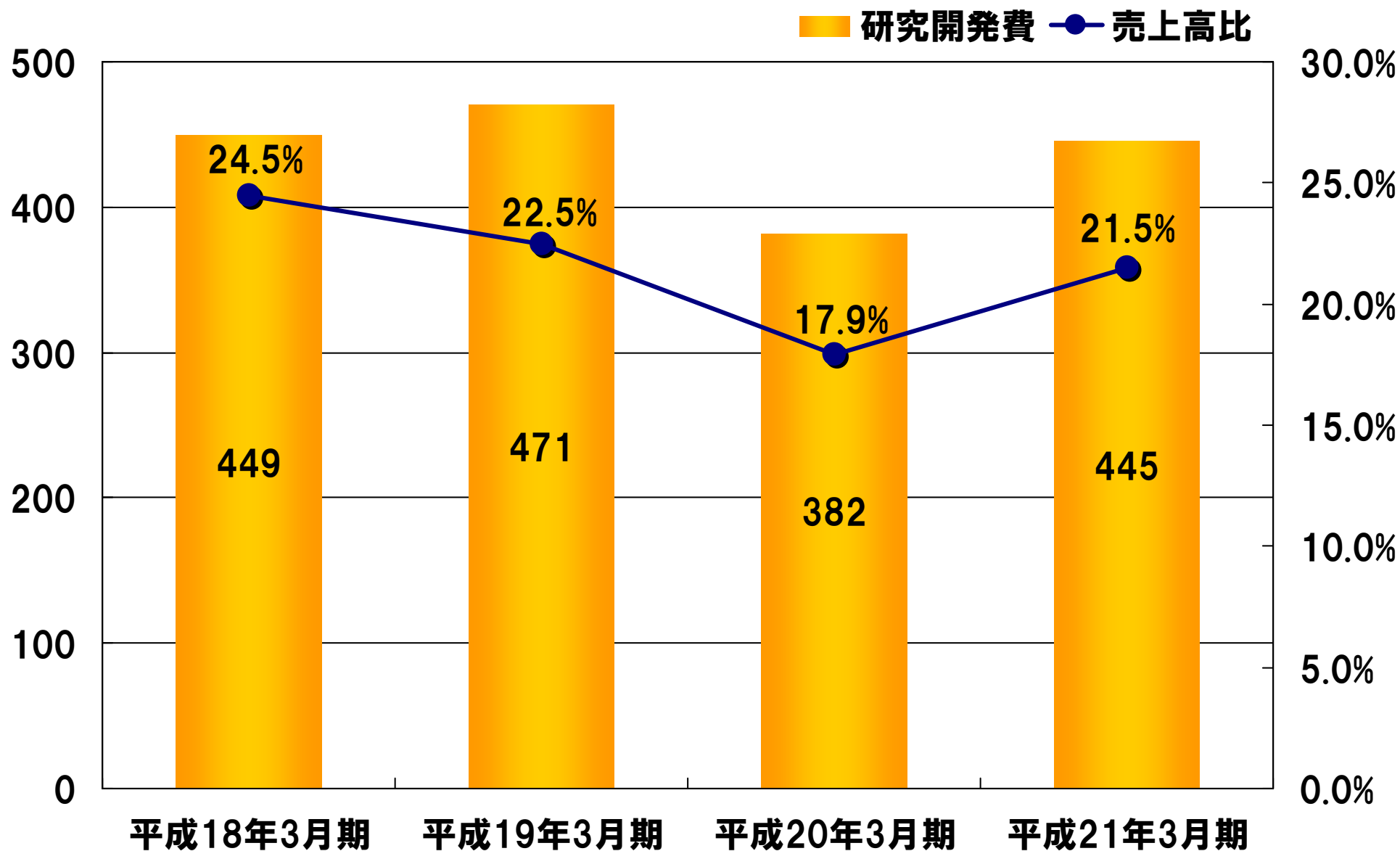


【期末要員数】

(単位:人)



(単位：百万円)



# 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	平成20年 3月期末	平成21年 3月期末	差異		平成20年 3月期末	平成21年 3月期末	差異
<b>(資産の部)</b>				<b>(負債の部)</b>			
<b>I 流動資産</b>	<b>1,894</b>	<b>1,474</b>	<b>△ 419</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>561</b>	<b>379</b>	<b>△ 181</b>
1 現金及び預金	1,348	1,070	△ 277	1 買掛金	148	63	△ 85
2 受取手形及び売掛金	421	298	△ 122	2 未払法人税等	115	28	△ 86
3 たな卸資産	27	13	△ 14	3 賞与引当金	87	80	△ 7
4 繰延税金資産	56	39	△ 16	4 その他	209	206	△ 2
5 その他	40	51	10	<b>負債合計</b>	<b>561</b>	<b>379</b>	<b>△ 181</b>
<b>II 固定資産</b>	<b>1,076</b>	<b>1,352</b>	<b>276</b>	<b>(純資産の部)</b>			
1 有形固定資産	24	21	△ 3	<b>I 株主資本</b>	<b>2,428</b>	<b>2,449</b>	<b>20</b>
2 無形固定資産	8	40	32	1 資本金	760	760	-
3 投資その他の資産合計	1,043	1,291	247	2 資本剰余金	890	890	-
投資有価証券	100	-	△ 100	3 利益剰余金	810	831	20
繰延税金資産	181	207	25	4 自己株式	△ 32	△ 32	-
長期預金	700	1,000	300	<b>II 評価・換算差額等</b>	<b>△ 19</b>	<b>△ 1</b>	<b>17</b>
その他	61	84	22	その他有価証券評価差額金	△ 21	-	21
				為替換算調整勘定	2	△ 1	△ 4
				<b>純資産合計</b>	<b>2,409</b>	<b>2,447</b>	<b>37</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,970</b>	<b>2,826</b>	<b>△ 143</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>2,970</b>	<b>2,826</b>	<b>△ 143</b>

# 連結キャッシュフロー計算書

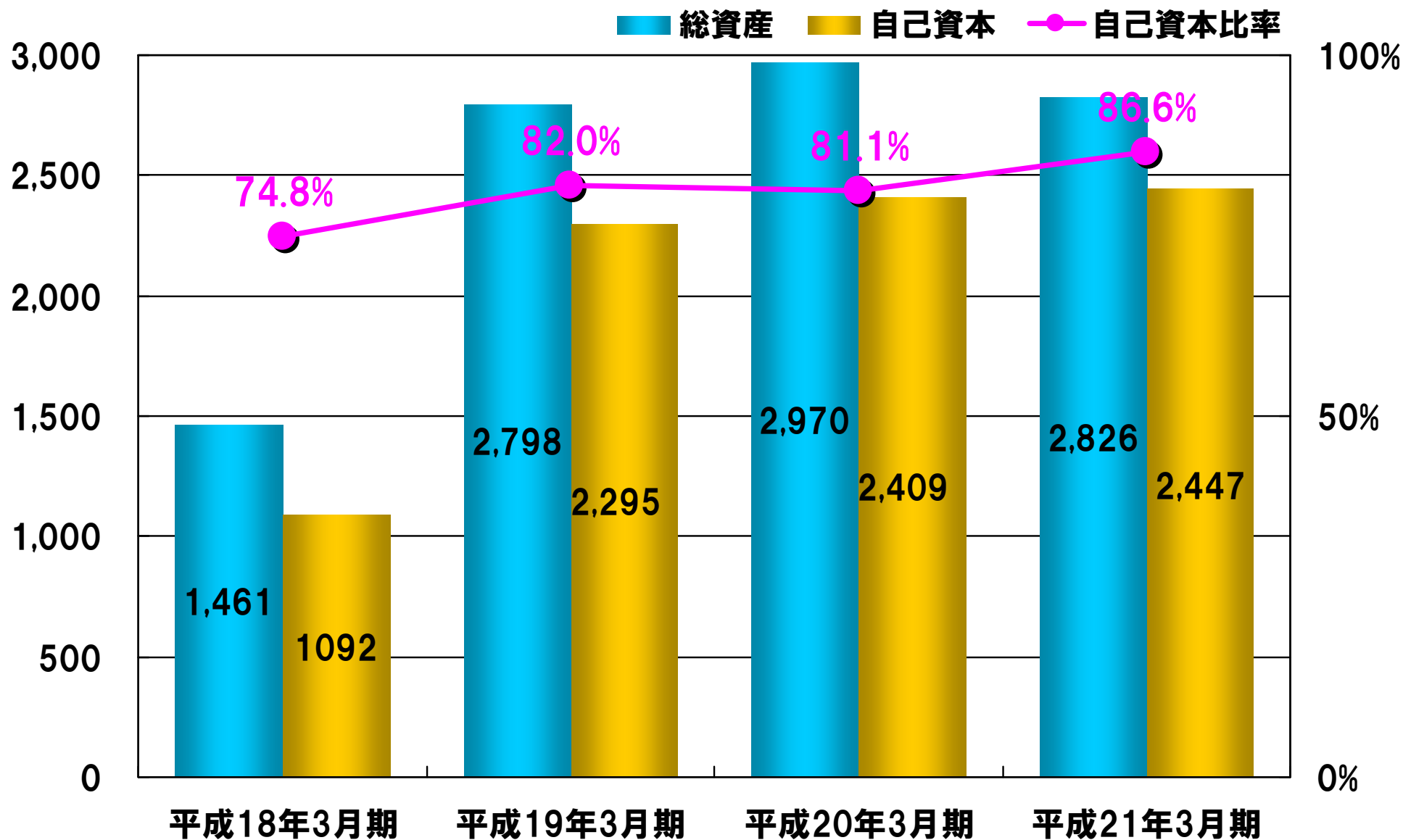
(単位：百万円)

	平成20年 3月期末	平成21年 3月期末	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	322	138	△ 183
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 829	△ 373	456
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61	△ 38	23
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△ 4	△ 4
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 569	△ 277	291
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,917	1,348	△ 569
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,348	1,070	△ 277



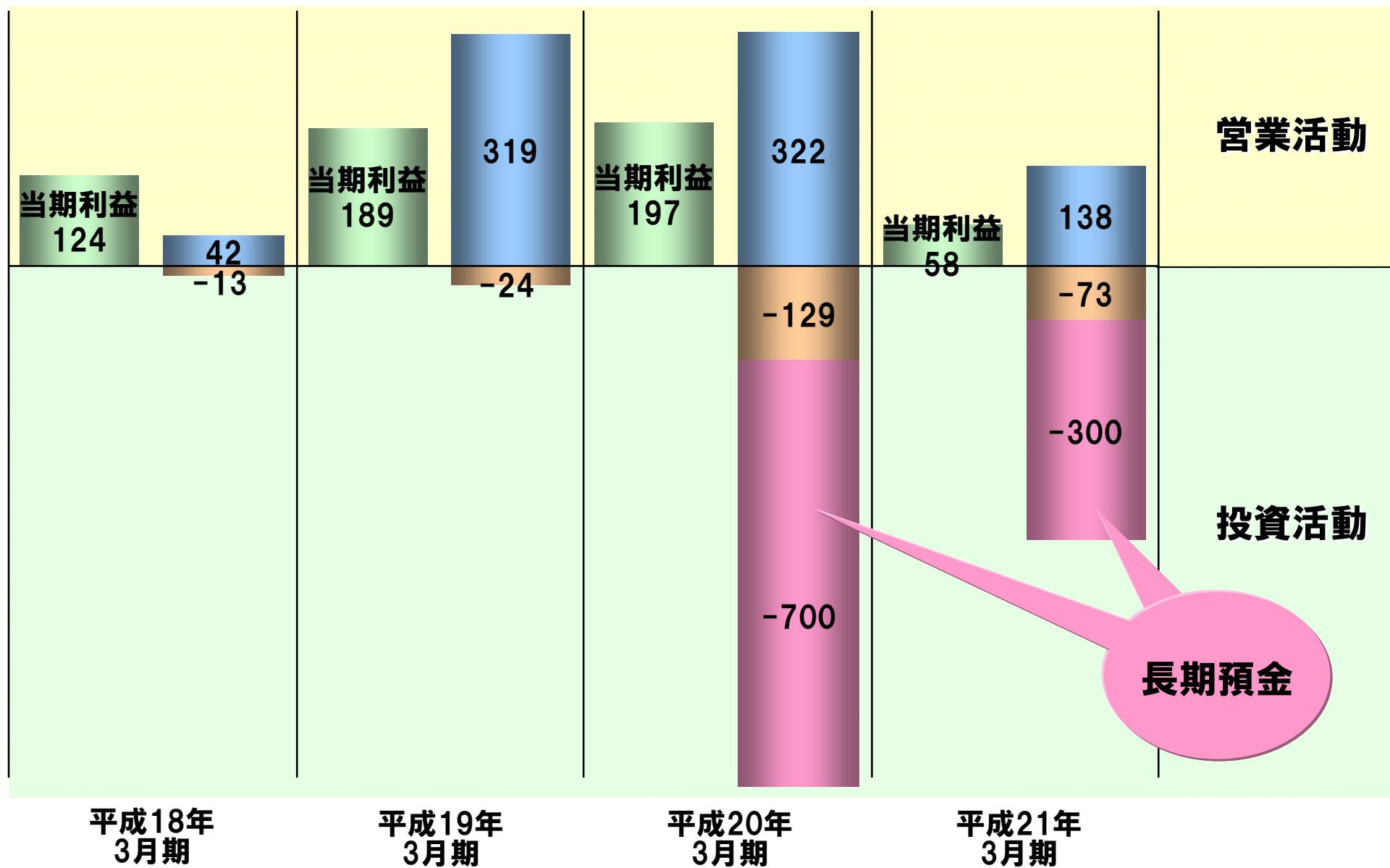
# 総資産・自己資本

(単位：百万円)



# 当期利益とフリーキャッシュフロー

(単位：百万円)



- **主力商品：α-SX V3.3.0をリリース（8月）**  
– 主に回路・レイアウト連携機能およびFPD設計機能を強化



- **有機ELパネル設計用2次元光学シミュレータの販売開始（10月）**  
– 有機ELパネル設計システムの強化



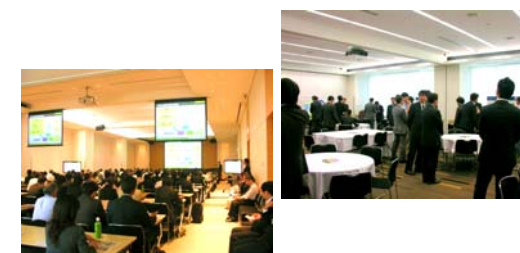
- **スタンダードセルライブラリ検証ツールの販売開始（10月）**  
– ライブラリ作成・検証機能の強化



- **Mentor社との提携：「Open Door」(10月)**  
– グローバル化の一環



- **プライベートショウを大阪・東京で開催（10月）**  
– 新製品を多数紹介  
– ユーザによるジーダット製品の運用事例紹介



- **NEC-EL向けプロセス・デザイン・キットの配布開始 (11月)**  
- オープン性拡大の一環

- **中国SMIC向けプロセス・デザイン・キットの配布開始 (11月)**  
- オープン性拡大の一環



- **EDSFair2009に出展 (1月)**  
- 上流系製品を中心に紹介



- **SRAM特性のばらつき解析を従来の600倍に高速化 (2月)**  
- NEDOから技術移管を受けてジーダットが高速化



- **主力商品:  $\alpha$ -SX V3.4.0をリリース (2月)**  
- 主に上流系設計機能の強化、FPD系高付加価値新製品





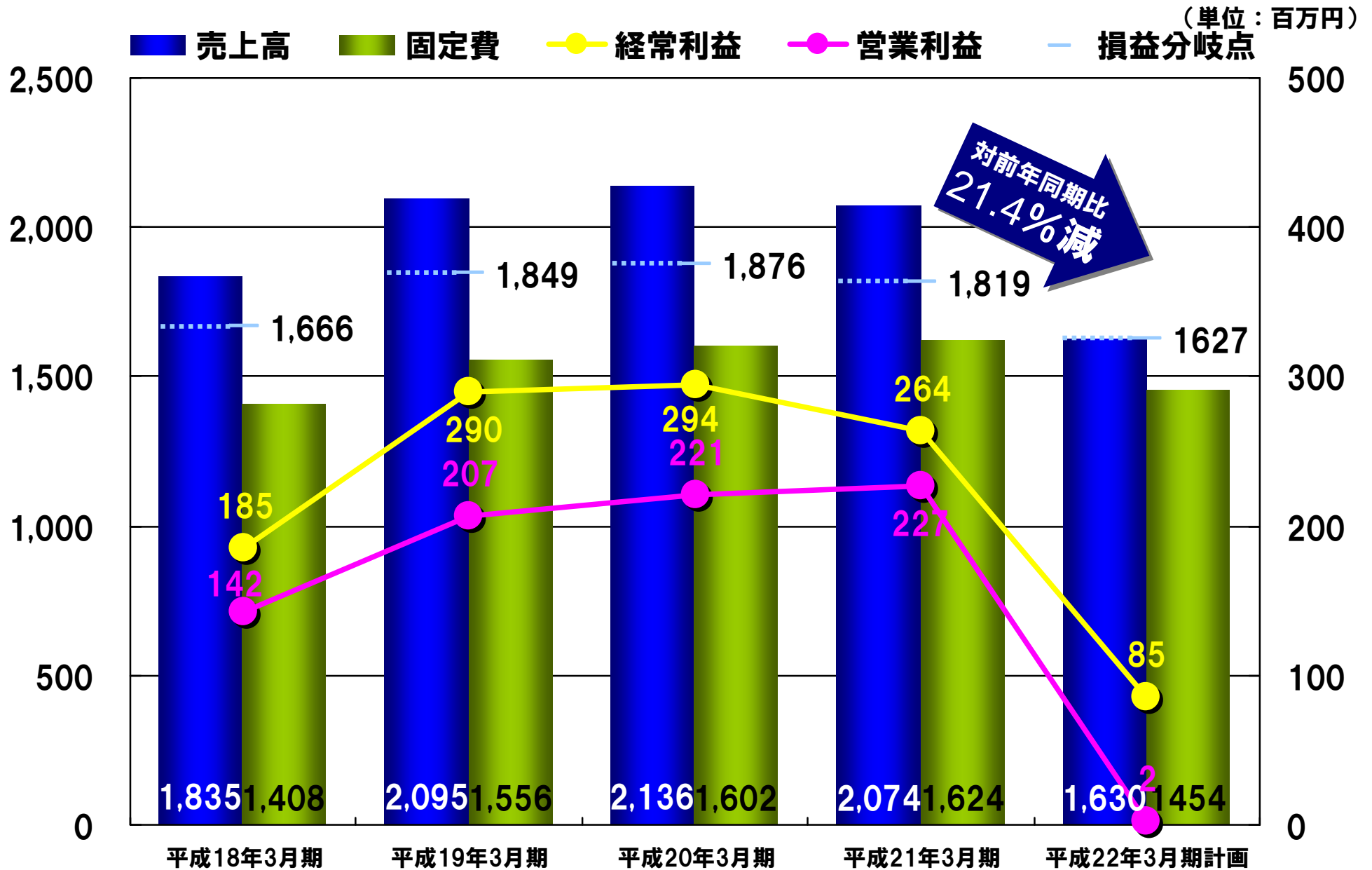
**国内景況悪化のため売上高が大幅ダウン**

**固定費圧縮により営業黒字を目指す**

**高比率の研究開発投資を継続**

**海外向け販売体制の重点強化**

# 売上・利益



顧客

EDA

受注激減・・・B/Bレシオ0.3

半導体業界の再編

- ロームがOKIセミコンダクタを吸収
- ルネサステクノロジとNECエレクトロニクスの統合
- 川崎マイクロエレクトロニクスが撤退

半導体業界各社の対象分野の絞込みと品種の絞込み

液晶パネル業界の再編

- 日立ディスプレイズ
- IPSアルファテクノロジー
- エプソンイメージングデバイス

設備投資抑制

製品  
売上  
大幅減

設計者の  
減少

サービス  
売上  
大幅減

# 営業黒字・固定費圧縮

(単位：百万円)

平成21年3月期  
営業利益実績

227

売上減少  
による影響

△395

平成22年3月期  
営業利益計画

2

31

研究開発費の圧縮

150

△12

営業外

△20

本社移転  
費用

新設計手法の  
普及に向けて

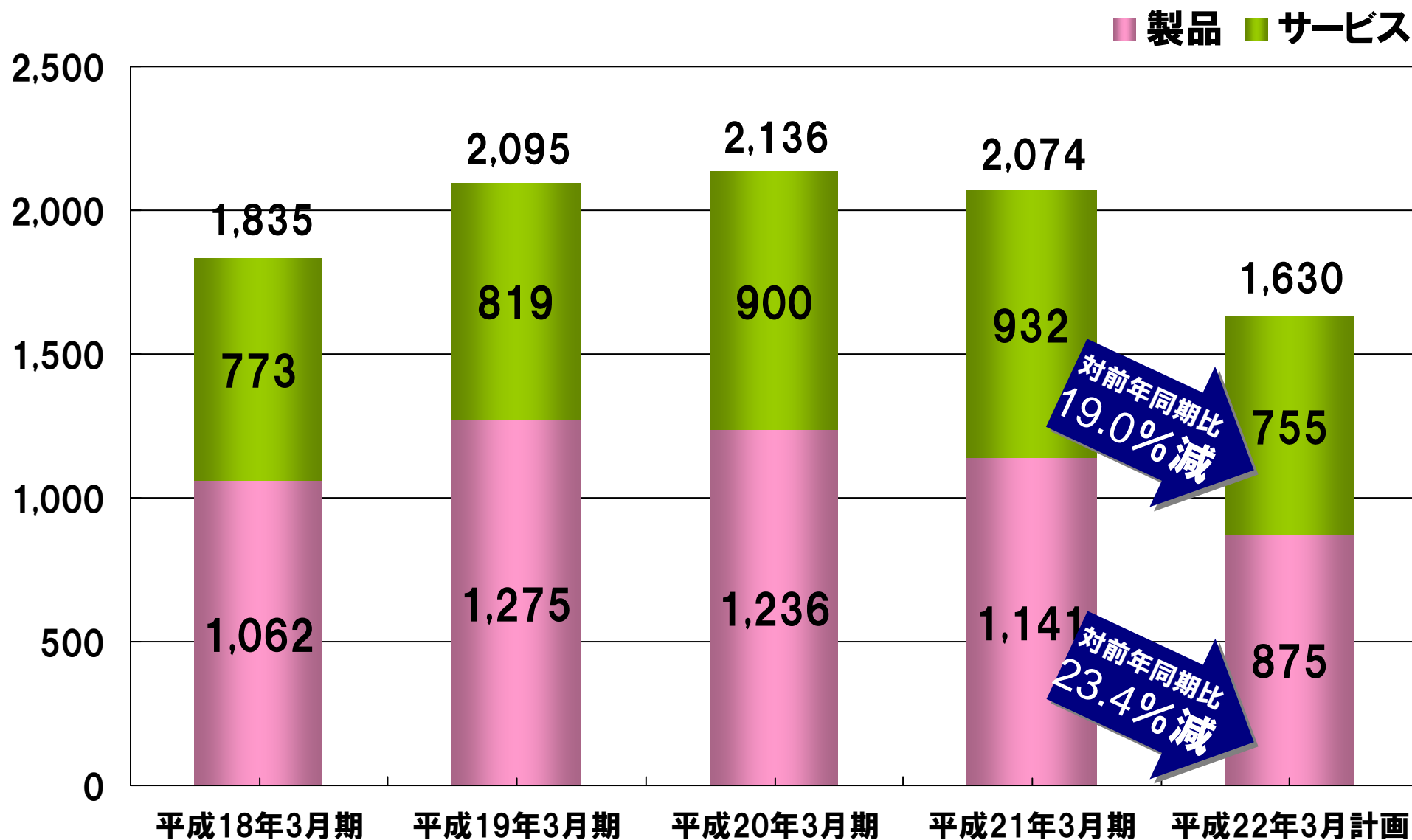
**固定費(除研究開発費)圧縮**

- ・ 役員報酬削減 (30~40%)
- ・ 幹部社員報酬削減 (5~10%)
- ・ 賞与引当金の圧縮
- ・ 外部委託費の削減
- ・ 交際費、広告宣伝費等削減



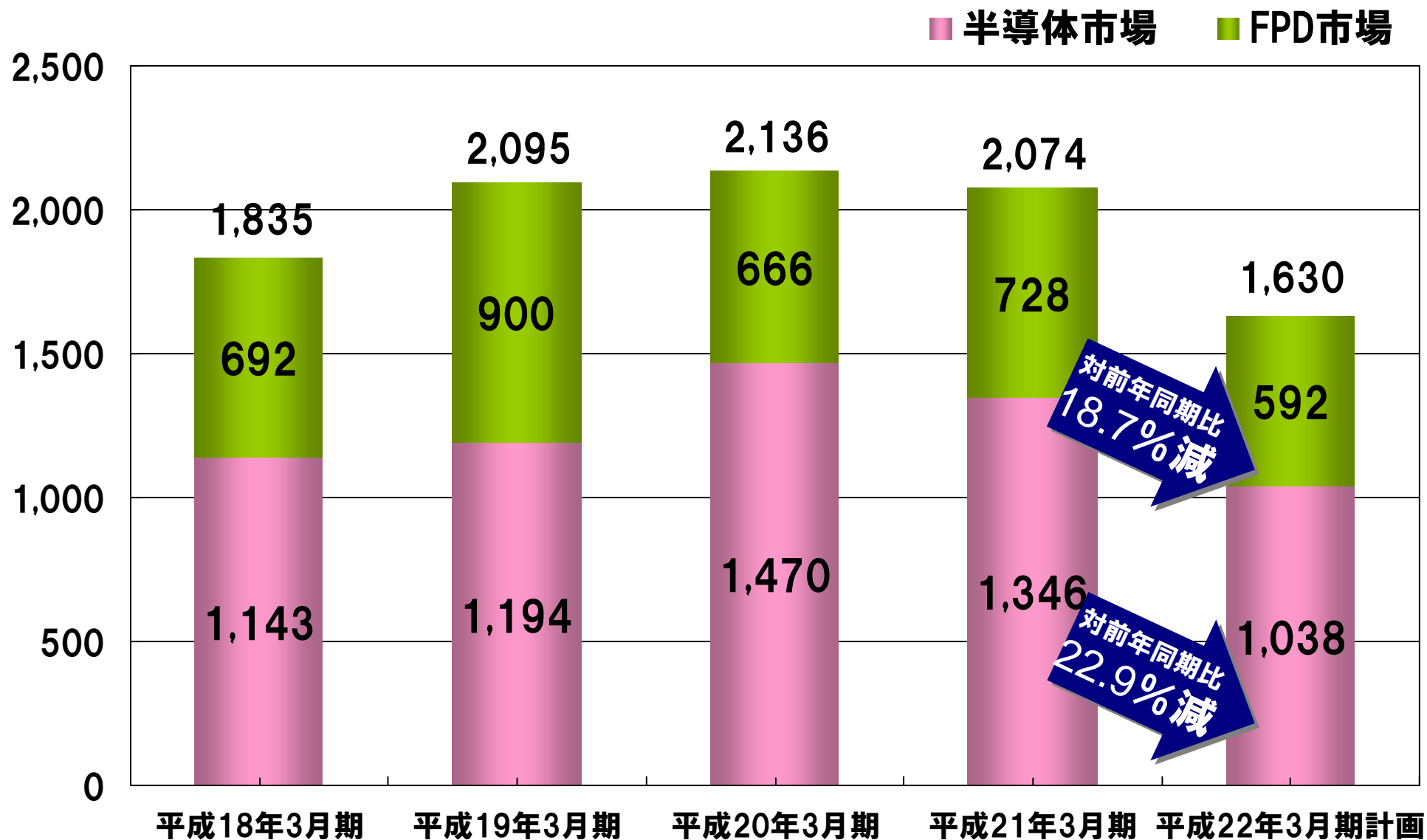
## 【製品／サービス】

(単位：百万円)



## 【半導体市場／FPD市場】

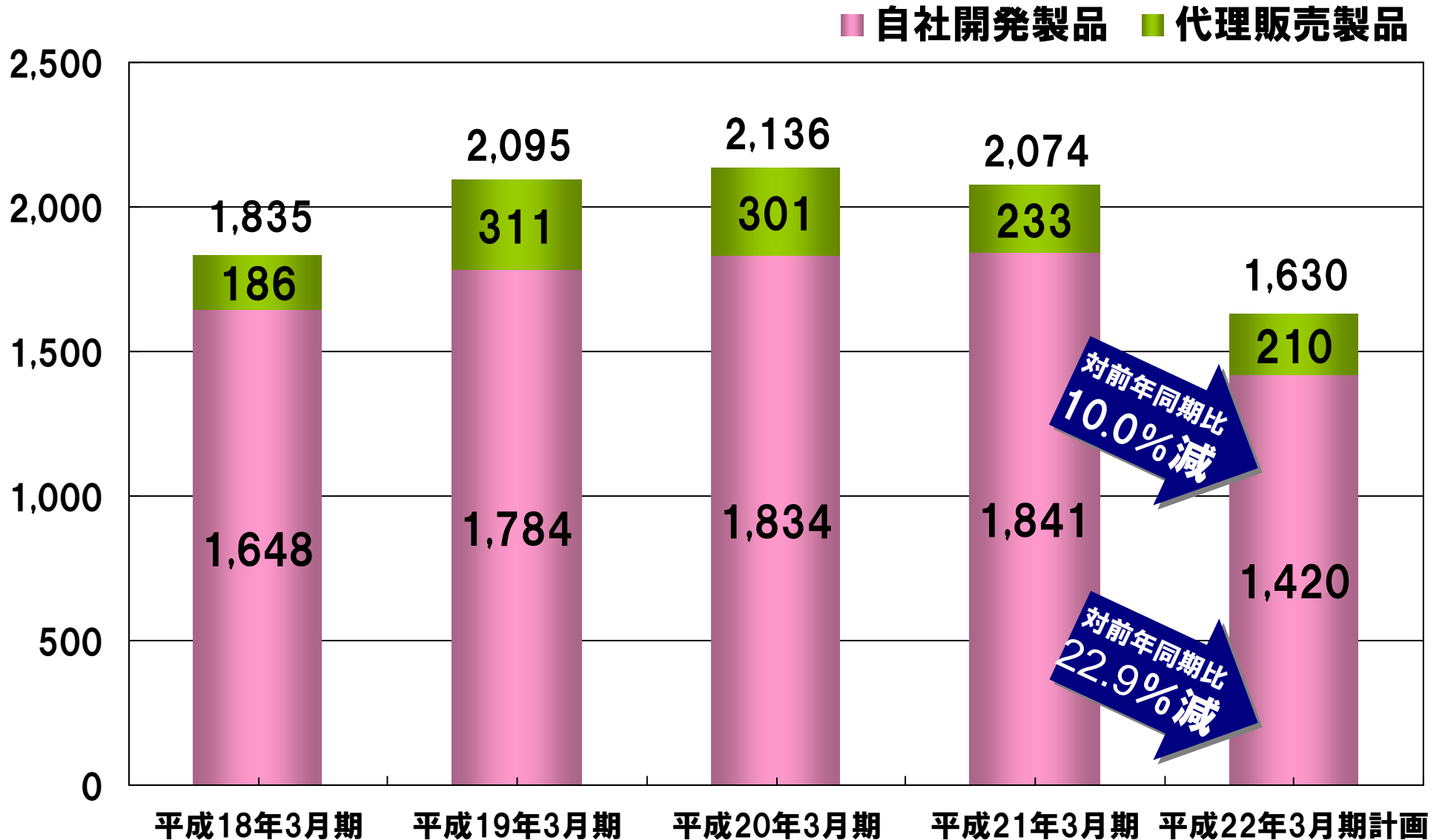
(単位：百万円)



# 製品区分別売上高の推移

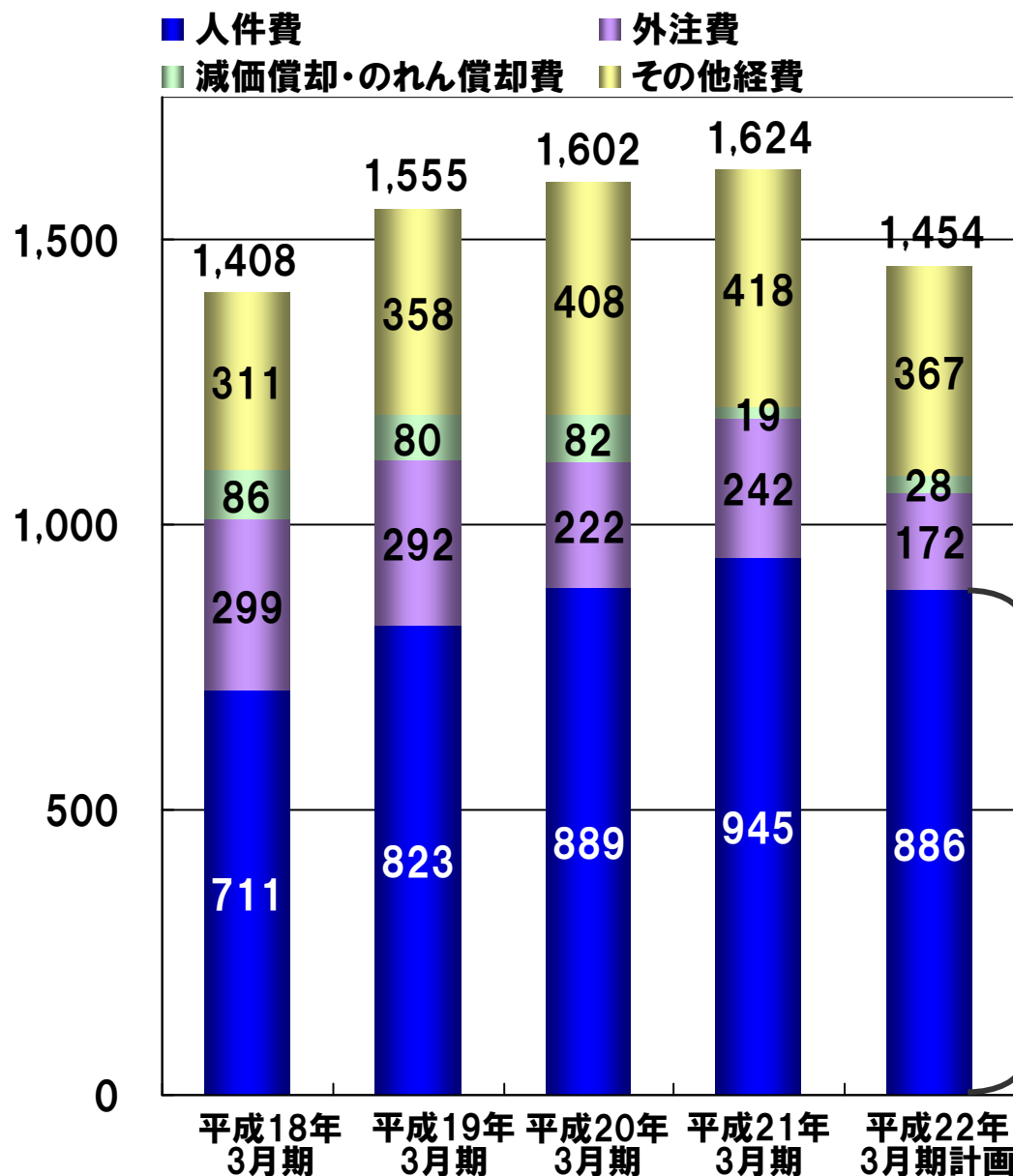
## 【自社開発製品／代理販売製品】

(単位：百万円)



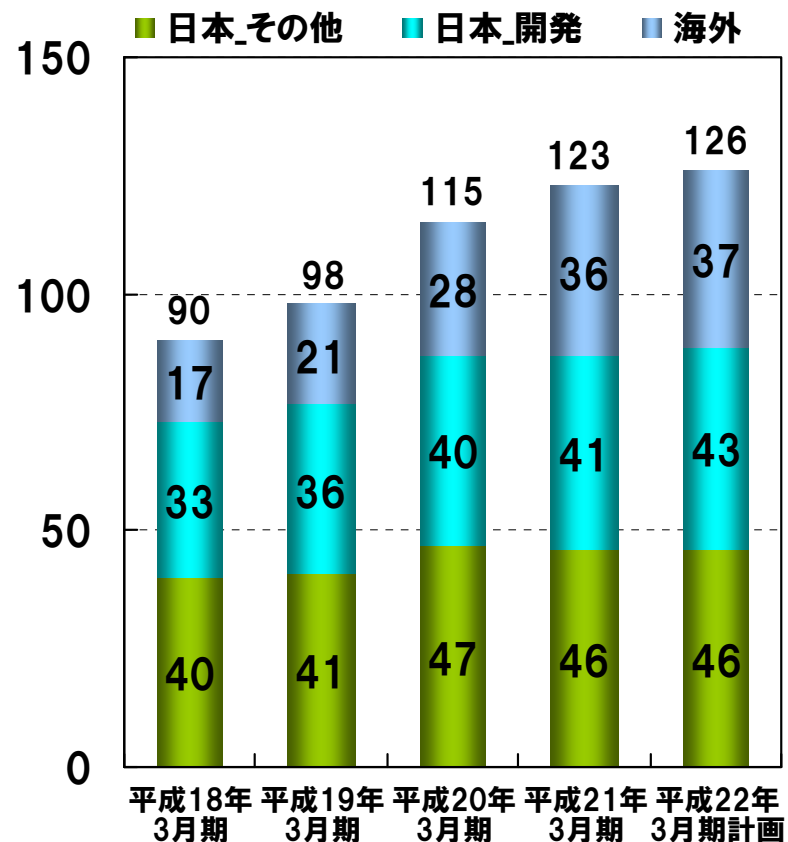
# 固定費内訳

(単位:百万円)



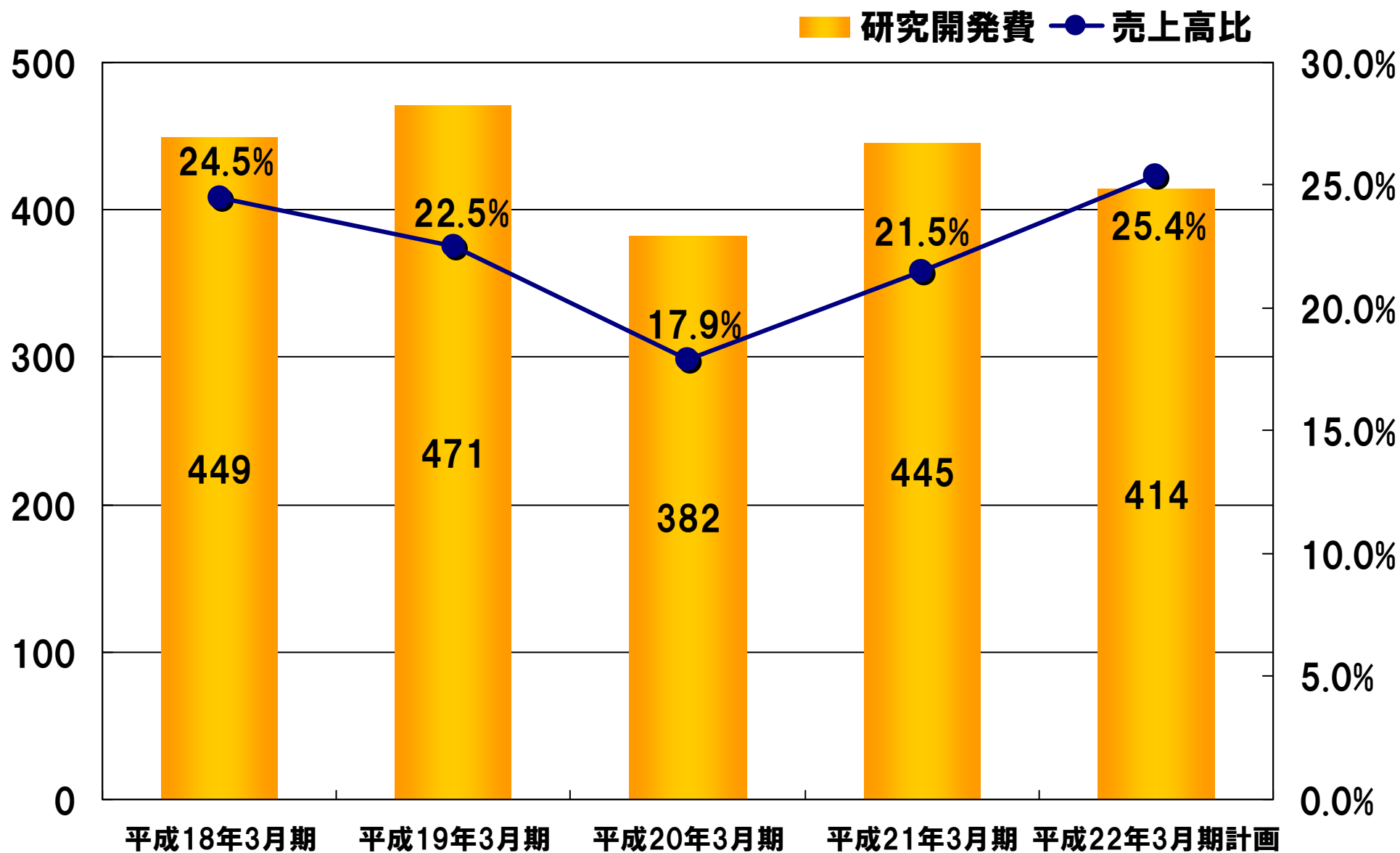
【期末要員数】

(単位:人)





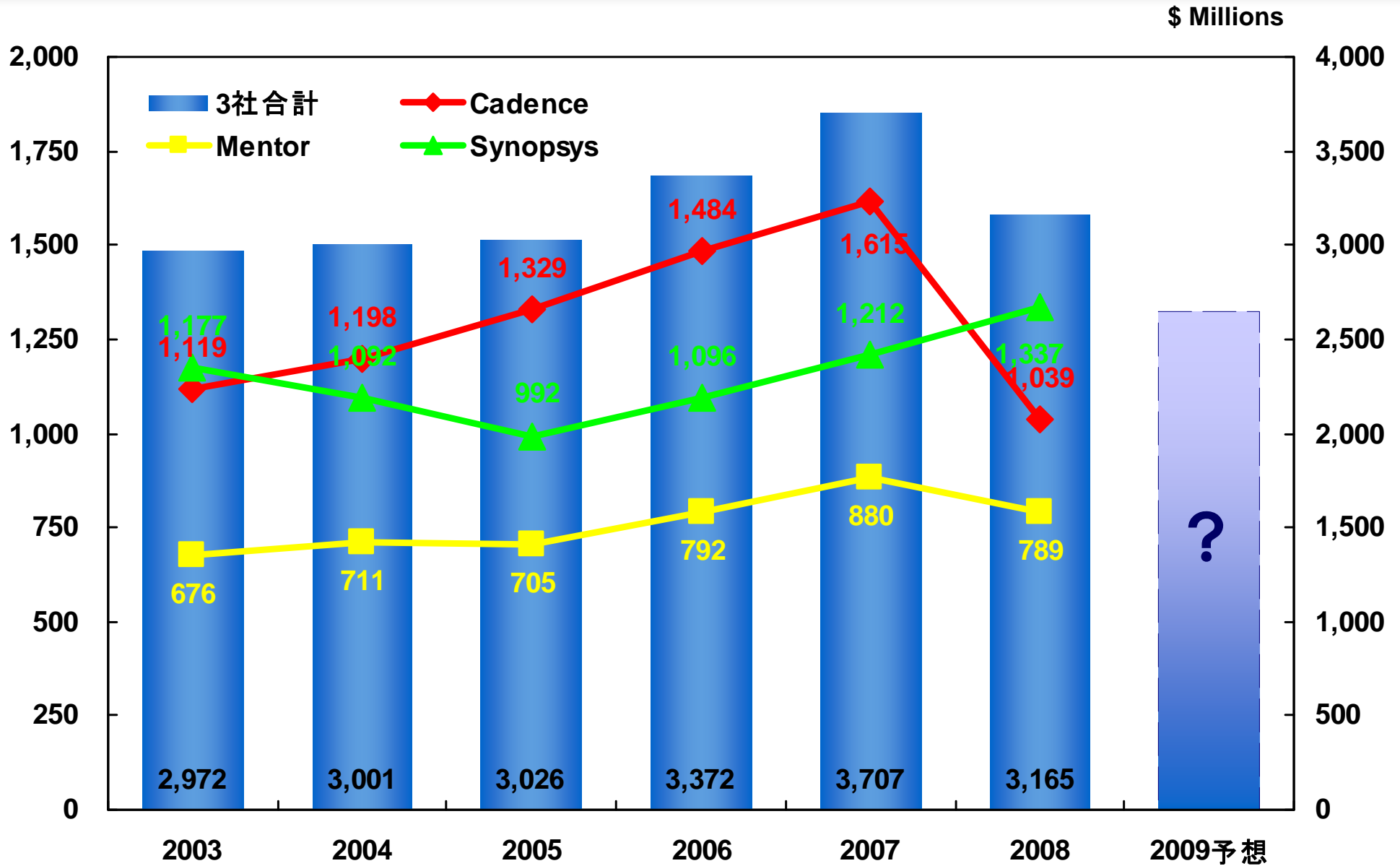
(単位：百万円)



# 難局を乗り越え成長に転じるために

- 今年は何とか耐えつつ来年、来々年に備える  
幸い資金繰りに問題はない・・・出直しの年
- 成熟市場における売上拡大とは即ちシェア拡大、他社リプレイスにほかならない
- 優位性のある製品 & 設計フローの更なる改良・性能向上に邁進する -----顧客の設計効率を3倍から5倍へ
- 当社製品・設計環境の使用効果を最大にするためのコンサルテーション力を継続的に強化する
- 海外、特に中国、韓国、台湾の営業活動を強化する

# EDA業界のトレンド ~Big3の売上



Source: Annual Reports

## 顧客技術者の大問題：

### ① 人がいない

- 設計効率を上げなければならない
- 設計品質は絶対に落とせない
- 新しい設計ツールを評価する余裕はない

### ② 金がない

- 外注出来ない
- レイアウト設計は慣れていない



**➡ 顧客が本当に困った今こそチャンス！**

## 半導体



現在、売上比の小さい(2%)回路設計分野での新製品開発を加速し2年後には比率を10%に高める

### シミュレーション精度 & 効率UP

- 高速高精度回路シミュレータ
- 新しい工夫によるシミュレーション回数の削減実現
- シミュレーション結果解析の高速化実現

競争力のあるレイアウト設計分野で売上拡大

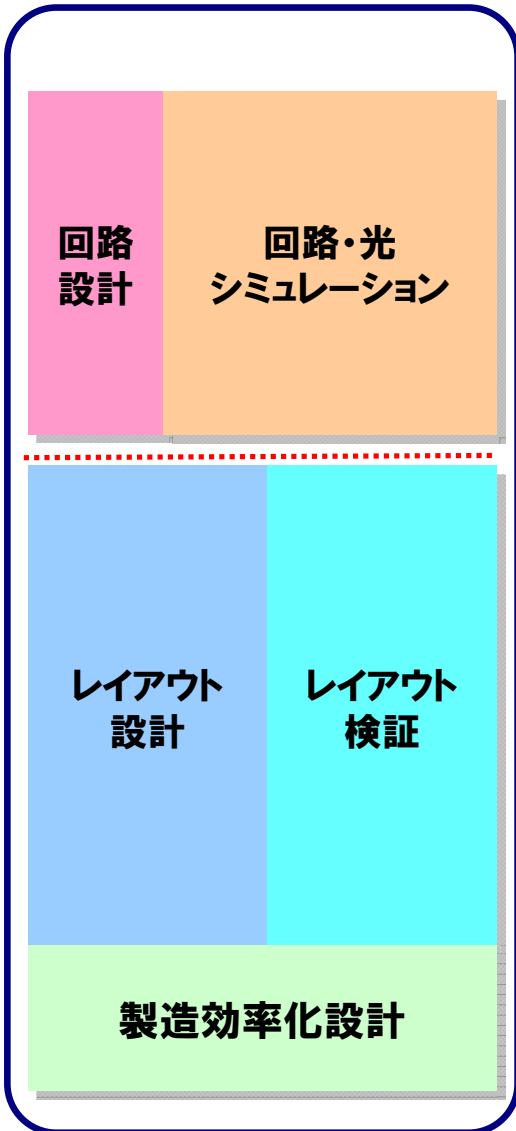
→ 自動設計を取り入れた新設計手法の提案強化

### 新設計手法の普及

- 新設計手法コンサルティングの強化
- 実設計における新設計手法活用  
→ 顧客との共同プロジェクト



## FPD



## 強みを活かした総取り戦略

- トータルな設計フロー
- 回路シミュレーションと光シミュレーションの統合設計環境
- 高精度・高速なLCD/OLED特有の抵抗・容量計算
- シミュレーションモデルの個別対応
- LCD/OLED特有の複雑な繰り返しパターンに対応した配線機能
- 顧客ごとの個別製造方式に合わせたカスタマイズ

**現在の海外販売比率5%を**  
**3年後には20%に上げる**

**中国FPD市場拡大への対応(α-SX)**

- サポート体制の強化と販売代理店支援強化
- 北京R&D子会社→事業拠点
- 上海にサポート拠点

**韓国FPD市場、台湾FPD市場の拡販(α-SX)**

- 販売代理店の支援強化
- 他社では出来ないこと(高精度高速抵抗・容量計算)から入る

## 韓国半導体市場の拡販(α-SX)

- アナログLSI, メモリ、ドライバーをターゲット
- 自動設計を取り入れた新設計手法の提案
- 販売代理店の支援強化

## HOTSCOPEの拡販

- 世界中の半導体市場をターゲット
- 販売代理店の増強

## 米国・欧州半導体市場の拡販(α-SX)

- アナログLSIをターゲット
- 自社AEを置く



**ご清聴ありがとうございました**

